

Ms 65 s/L  
SMD – RFID Transponderspule

**Kennzeichen**

- Großer Induktivitätsbereich
- Automatisch bestückbar
- Für Reflow- und Dampfphasenlötung
- Ansaugfläche (ASF) optional
- **Verklebung mit PCB durch HSF (optional)**
- Gute Vibrations- und Falltesteigenschaften

**Anwendungen**

Transponder-Antennen, Entkopplung in HF- und ZF-Schaltungen, Einsatz in selektiven Kreisen

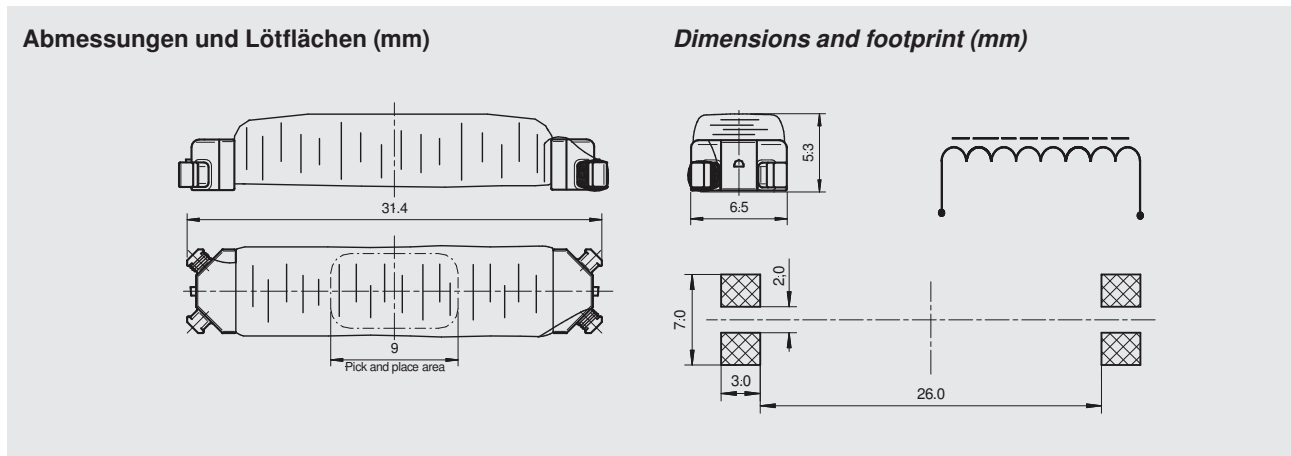
Ms 65 s/L  
SMD – RFID transponder coil

**Features**

- Wide inductance range
- Suitable for automatic insertion
- For reflow and vapor phase soldering
- Pick and place area (optional)
- **Glueing with PCB by HSF (hot melting dot) (optional)**
- Good vibration- and drop test performance

**Applications**

Transponder antennas, decoupling in RF- and IF-circuits, use in frequency selective circuits



**Induktivitätsbereich:**

10 µH - 39 mH

**Empfohlene**

**Löttechnik:**

Reflow

**Max. Löttemperatur:**

260°C, 10 Sek.

**Betriebs-**

**temperaturbereich:**

-40°C bis + 125°C

**Verpackung:**

siehe Verpackungsvorschrift, Blisterpack DIN EN 60286/3

**Inductance range:**

10 µH - 39 mH

**Recommended soldering method:**

Reflow

**Soldering heat**

**resistance:**

260°C / 10 sec.

**Operating**

**temperature range:**

-40°C to + 125°C

**Packaging:**

see tape and reel specifications, Blisterpack DIN EN 60286/3

**Vorläufige Daten | Preliminary data**

L [mH]	Q ≥	f <sub>L,Q</sub> [kHz]	f <sub>res</sub> ≤ [MHz]	R <sub>DC</sub> ≤ [Ω]	I <sub>max</sub> [mA]	s [mV/A/m]	Art.-Nr. part number
1	50	125	0,9	1,1	200	70 *	00 6169 53
2,2	40	125	0,5	1,7	120	130 *	00 6169 52
3	50	125	0,45	2,1	100	170 *	00 6169 54
3,74	27	5,5	0,4	2,7	100	-	00 6169 51
3,74	27	21,8	0,4	2,7	100	18 * <sup>1</sup>	00 6169 51
5	50	125	0,33	4	90	210 *	00 6169 55

Gluing with PCB by HSF optional

S-measurement with Helmholtz coil at \*) 125 kHz \*<sup>1</sup>) 21,8 kHz

Weitere Werte auf Anfrage.

Further values on request.